

画像センシング展2026

ミニブースのご案内

画像センシング展2026



● 新規コーナー出展社募集！！

画像センシング展は2026年で40回目の開催を迎えます。
産業用画像機器・画像処理技術に優れた専門性を持つ出展社が一堂に会する展示会です。商談確度の高い方々が多く来場すること、また、出展社同士のコミュニケーションが盛んなことも魅力です！

会 期 2026年6月10日(水)～12日(金)

会 場 パシフィコ横浜 展示ホールD

展示規模 **136社／235小間** (※2025年実績)

来場者数 **10,374人** (※2025年実績)

※昨年の開催実績は以下URLより

<https://www.adcom-media.co.jp/pdf/iss/houkoku.pdf>

画像センシング展 来場者の特長

●業種

精密・機械、電機、電子部品、半導体、システムインテグレーターなど。

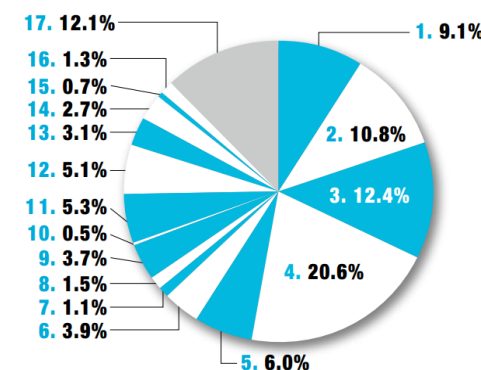
●職種

営業、技術、研究・開発、設計、経営層など。

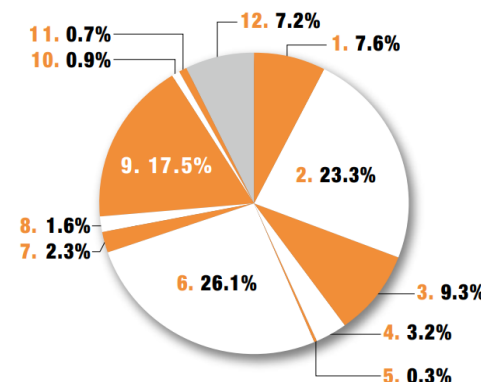
●製品購入への関心度

製品購入を**決定・検討・審議・提案**を行う来場者が **約70%** を占めています。

業 種	
1 半導体	10 食品・水産・農林
2 電子部品	11 情報・通信
3 電機	12 サービス・商業・流通
4 精密・機械	13 建設・設計・交通・運輸
5 システムインテグレーター	14 官公庁・学校
6 輸送用機器	15 マスコミ・広告
7 製紙・印刷	16 航空・宇宙
8 資源・素材・エネルギー	17 その他
9 化学・バイオ・医療	



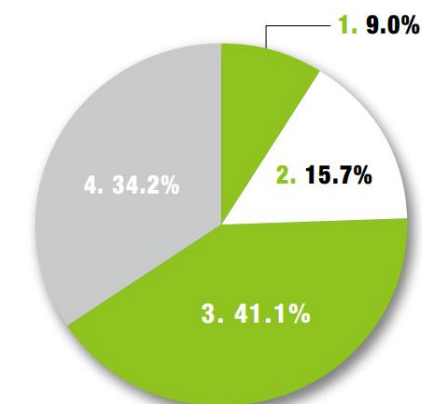
職 種	
1 役員	9 研究・開発
2 技術	10 教員
3 設計	11 学生
4 製造	12 その他
5 総務	
6 営業	
7 管理	
8 広報・宣伝	

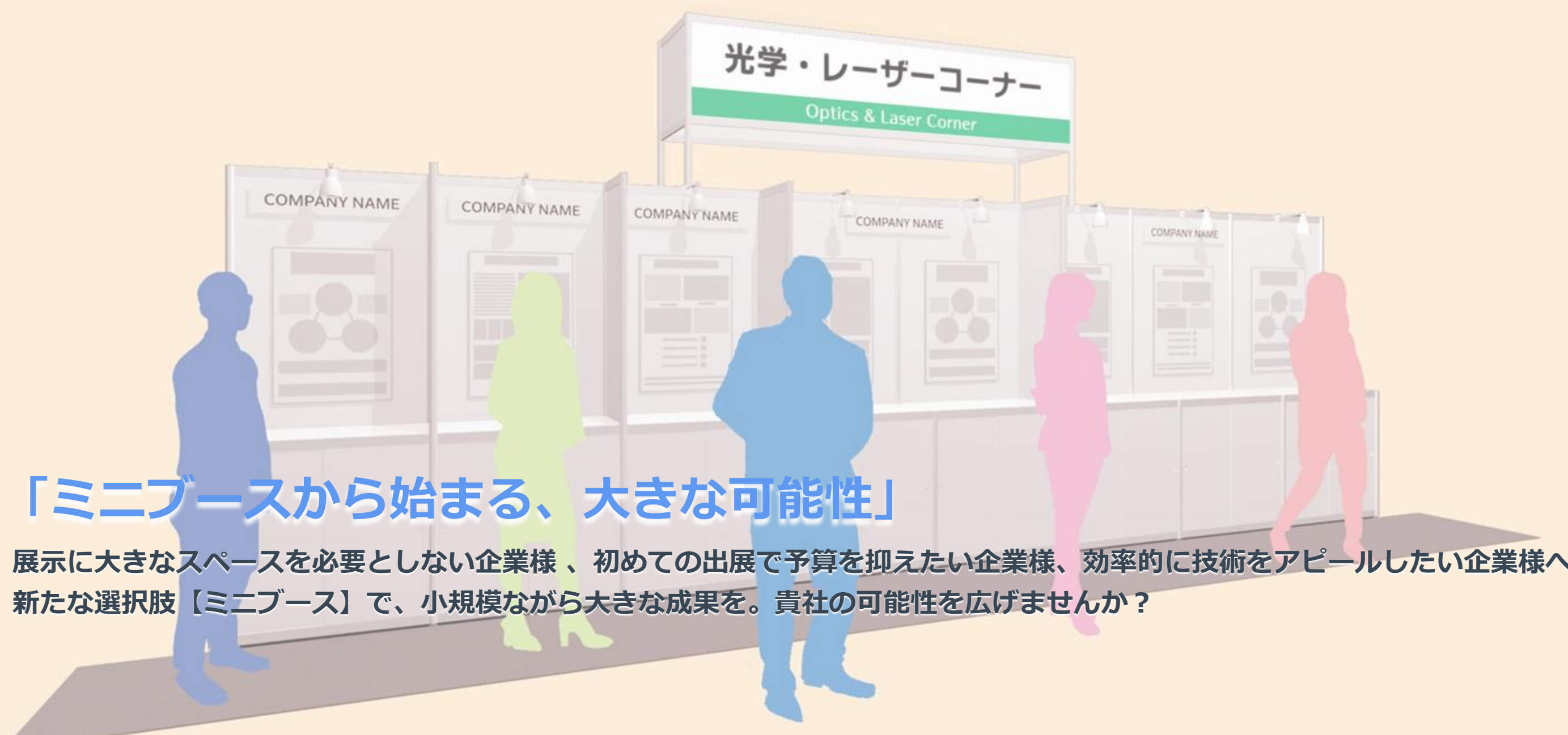


ご来場者の立場

- 購入を決定
- 購入を検討・審議
- 選定・提案
- 選定に関わらない

製品購入を決定、検討・審議、選定・提案を行う来場者が約70%を占めています。



An illustration of a trade show booth. At the top, a large sign reads '光学・レーザーコーナー' (Optics & Laser Corner) in Japanese, with 'Optics & Laser Corner' written below it in English. The booth consists of several white panels, each labeled 'COMPANY NAME' at the top. Each panel features a diagram or chart. Five stylized human figures in blue, green, blue, pink, and red are standing in front of the booth, looking at the displays. The background is a solid light orange color.

光学・レーザーコーナー

Optics & Laser Corner

COMPANY NAME

COMPANY NAME

COMPANY NAME

COMPANY NAME

COMPANY NAME

「ミニブースから始まる、大きな可能性」

展示に大きなスペースを必要としない企業様、初めての出展で予算を抑えたい企業様、効率的に技術をアピールしたい企業様へ
新たな選択肢【ミニブース】で、小規模ながら大きな成果を。貴社の可能性を広げませんか？

イメージ図

出展対象①

「光学・レーザーコーナー」

光学・レーザー技術は、製造・医療・通信・宇宙など幅広い分野の基盤技術です。微細加工、非接触計測、光通信、医療、自動運転センシングなどに活用され、社会の高度化と産業革新を支える次世代技術の鍵を握る重要分野です。

光学部品・材料

- レンズ（球面・非球面）
- ミラー
- プリズム／ビームスプリッター
- 光学結晶・コーティング

レーザー関連

- 半導体レーザー
- ファイバーレーザー
- 固体レーザー
- レーザー応用装置（加工・計測）

光センシング・分光・偏光

- LiDAR
- フォトダイオード
- 分光器（ラマン／赤外）
- 干渉計

光学設計・シミュレーション

- 光学設計ソフトウェア
- 光学コンサルティング

etc



出展対象②

「先端要素技術コーナー」

先端要素技術は、イメージセンサー、レンズ、照明、画像処理アルゴリズムが連携し、マシンビジョンの性能・精度・信頼性を支えます。

AI、ロボット、半導体など先端分野の基盤として、製造現場の自動化、品質向上、脱炭素対応に貢献し、日本の経済と技術力を支える重要な鍵となります。

センサー・検出デバイス

- イメージセンサー（CMOS、赤外、InGaAs など）
- MEMSセンサー・特殊センサー（加速度、圧力、バイオ、テラヘルツ など）

精密加工・製造技術

- 精密加工技術（超精密切削、微細加工）
- 薄膜・ナノ加工／コーティング技術

先端応用・評価技術

- 量子イメージング・ナノフォトニクス
- 計測・評価装置（試験・信頼性評価機器を含む）

デジタルソリューション・実装技術

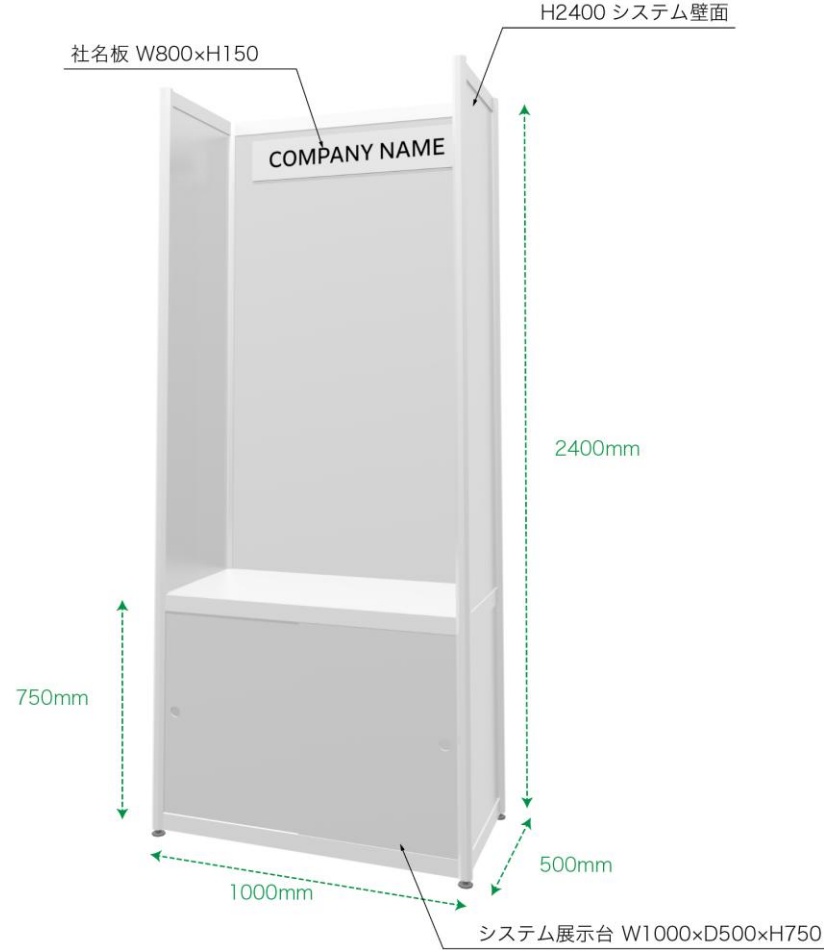
- エッジコンピューティング／組込み機器
- AI実装デバイス（AIチップ、推論アクセラレータ）

マテリアル

- 特殊材料・光学材料（結晶、フォトニック材料、耐環境材料など）

etc

小間仕様・価格



小間仕様

●小間寸法：

約1000 (W) ×500 (D) ×2400 (H)

システムパネル、展示台(1000(W)×500(D)×750(H)mm)、通常文字社名板(1小間につき1枚)は事務局でご用意いたします。

製品を床に設置して展示する場合など、展示台が不要の場合は取り除くことが可能です。

複数小間(横並び)のお申し込みも可能です。

※展示台は耐荷重20kgです。

※展示台の下は空いておりますので梱包材等の収納が可能です。



イメージ図

料金

●1小間につき 120,000円 (税込132,000円)

※ディスプレイ(システムパネル、展示台、通常文字社名板)、出展社証代が含まれております。

※小間外(通路)に物を置くことはできません。

※ロゴ指定社名板は別途(有料)承ります。

※出展各社による小間内装飾も可能です。

※電力(配線、アース、その他)、小間内テーブルの有無等の申込書は、4月下旬にE-mailにてお送りいたします。

ミニブース出展の5つのメリット

1. コスト削減

テーブルトップブースの**約半分の出展料**で、効率的に技術や製品をアピール。予算を大幅に抑えながら、高い展示効果を実現します。

2. 集中展示

限られたスペースを最大限に活用し、コア技術・製品に焦点を絞った展示が可能。来場者の関心を確実に引きつけ、**集中的なプレゼンテーション**を行えます。

3. 専門家との出会い

特定分野に特化したコーナーで、ターゲットとする業界の専門家や潜在顧客と**効率的な接点**を創出。質の高い出会いがビジネスチャンスを広げます。

4. 市場反応の調査

新しいアイデアや技術に対する市場の反応を、**低コストかつ迅速に調査**。次の開発ステップに向けた貴重なフィードバックを効果的に収集できます。

5. 出展社交流

同じコーナー内の出展者様との交流が活発になり、新たなビジネス協力の機会が生まれます。**限られたスペースから無限の可能性**が広がります。

お申込み方法

1ブースあたり
早期予約は **24,000円** お得！

👉 ✨ 早期予約特典！ ✨

2025年12月末日までにご予約いただくと、出展料が20% OFFの特別価格に！

1小間あたり ~~¥120,000~~ → **¥96,000** (税別)

※割引は出展料のみ対象となります。電気代・その他のオプションは対象外です。

※お申込みは通常ブース同様、1月末にオープンする展示会サイトよりお願いいたします。

※予約段階でのキャンセル料はかかりません。

早期予約はコチラから



<https://forms.gle/itGnQw6K5UWeEdZp9>



【お問い合わせ】

画像センシング展2026 事務局

Mail : exhibit@adcom-media.co.jp

Tel : 03-3367-0571